

食品包装セミナーのご案内

「食品包装セミナー」は、2022年度もオンライン（Zoom）で開催いたします。
ご参加よろしくお願ひ申し上げます。

2022年度 第6回食品包装セミナー

開催日時：2023年1月19日(木) 15:30～17:00

参加費：日本食品包装協会会員：3,000円／一般：5,000円

講演名

『分別塗工ラミネート方式による新規無溶剤型接着剤(DUALAM)の開発』

セカイテキナ環境意識の高まりを受け、ラミネート接着剤は無溶剤型に移行する流れが加速する一方で、加工性・作業効率性に難があるため大きな足かせとなっております。DICはその課題解決のため、接着剤だけでなく従来の塗工方式についても根本的に見直しました。本講演では、パッケージ生産を低環境負荷生産に移行させる画期的なシステムとして、分別塗工ラミネート方式及び専用の新規無溶剤型接着剤(DUALAM)について、ご紹介致します。

『DICの考えるポリスチレンの完全循環型社会の実現』

ポリスチレンの完全循環型社会に向けDICでは①溶解分離リサイクル（Dic法）と②ケミカルリサイクルなどの取り組みを進めています。マテリアルリサイクルのひとつであるDic法と外部パートナーとの連携で進めているケミカルリサイクルの取り組みについてご紹介致します。

講演者

DIC株式会社 パッケージ技術本部 パッケージ技術 1G 新居 正光氏

<略歴> 2007年大日本インキ化学工業(株)(旧社名)入社、東京工場配属、パッケージ用ラミネート接着剤や欧州向けラミネート接着剤(英国にて)の開発・技術サービスを担当、2015年DIC(株)に東京工場に復帰、PASLIMや分別塗工ラミネート用無溶剤型接着剤の開発・技術サービス担当を兼任

DIC株式会社 パッケージングマテリアル製品本部長付 内田 慶一氏

<略歴> 2008年DIC(株)入社、石化技術本部、2021年パッケージ技術本部、2023年パッケージングマテリアル製品本部長付

参加申し込み方法と注意事項

- ◆お申込みは、別紙の「参加申込書」にてメールによりお申込みください。
(ホームページからも参加お申込みできます。)
- ◆定員：先着順 100 名様
- ◆お申込み締切：2023年1月17日(火)
- ◆全般に亘って Zoom を使用しますので視聴環境の準備、確認をお願いします。
- ◆ご聴講はお申込みご本人様のみとなります。
- ◆申込期間（2022年12月〇日～1月17日）以降のお申込み取消、無連絡不参加につきましては、当該参加費を申し受けますこと、予めご了承ください。

◆お問い合わせ先◆

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-10-5 富士ビル6 3階

一般社団法人 日本食品包装協会 担当：石井、山岡、藤田 受付時間：11時～16時（土日祝を除く）

TEL:03-3669-0526 FAX:03-3669-1244 HP: shokuhou.jp/